

WINPAC

Winner in Package & Test

*Building the Next Growth Engine
through Technology*

고객과 함께 성장하는 글로벌 OSAT 파트너



Investor Relations
June 2026

Disclaimer

본 자료는 기관 및 일반 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 원팩 (이하 “회사“)에 의해 작성되었으며, 본 자료를 복사, 재생, 배포 또는 게재하거나 다른 목적으로 사용하는 것은 엄격히 금지됨을 알려드립니다. 본 Presentation에 참석하는 경우 위 내용에 대한 동의로 간주되며, 만일 위 사항을 위반하는 경우 동시에 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 위반에도 해당할 수 있음을 유념하시기 바랍니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”는 개별적인 확인 절차를 거치지 않은 정보입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무 실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’ 등과 같은 단어를 포함합니다. “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 영향을 받을 수 밖에 없어 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제의 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려하여 작성된 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 투자자에 대한 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다.

본 자료의 활용으로 인하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 과실 등의 여부를 불문하고 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 본 자료는 주식의 모집 또는 매매의 청약에 대한 권유에 해당되지 않습니다.

Contents

WINPAC

The Transformation of OSAT

국내 IDM 중심 후공정 업체에서 Global Fabless 기반 Turn-Key OSAT로 진화

01

Executive
Summary

02

Company
Overview

03

Growth
Engine

04

Investment
Highlights

Why WINPAC Now?

사업구조 개선 효과가 가시화되며 실적 턴어라운드 본격화

WINPAC은 사업구조 개선 효과가 가시화되고 있으며, 신규 성장동력을 기반으로 실적 회복 국면에 진입

D 주요 개선 현황



Why WINPAC Now?

사업구조 다각화와 수익구조 개선을 통해 실적 턴어라운드를 실현하는 OSAT 전문 기업

중국 시장 확대, Wafer Test 진출, Turn-key 서비스 구축을 기반으로 지속 가능한 성장 기반을 강화하고 있습니다.



중국 Fabless 시장 선점

- Rayson, Xinrongda 등 주요 중국 Fabless 기업과 협력
- 모바일, PMIC, 저전압 반도체 분야에서 주요 고객사 확대 강화



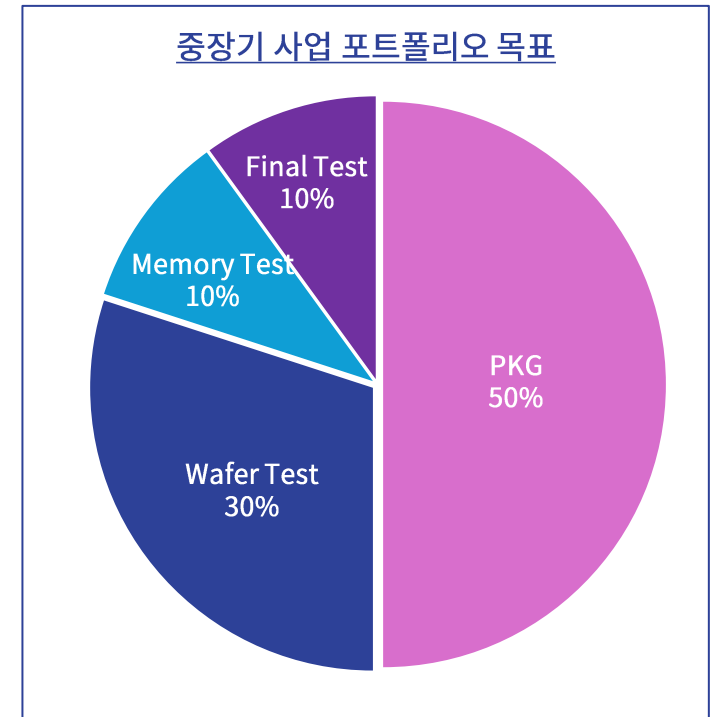
"S"사 진입 통한 Wafer Test 사업 확대

- S사 파트너십을 통해 안정적인 물량 확보 및 수익성 개선
- 국내외 Test 전문 기업들과의 협력, 투자 유치를 통해 최신 Wafer Test 장비 도입



Turn-key Biz 구축(PKG + Test 통합 서비스)

- 설계→Wafer Test→Packaging→Final Test One-Stop 통합 서비스 제공
- 특수 패키지/저전력 비메모리 제품까지 커버
- Full Turn-key Service 체계를 구축 → 고품질/비용 절감을 동시에 실현



- ✓ PKG 중심에서 Test 사업 비중 확대
- ✓ 고부가치 사업 중심으로 수익성 극대화

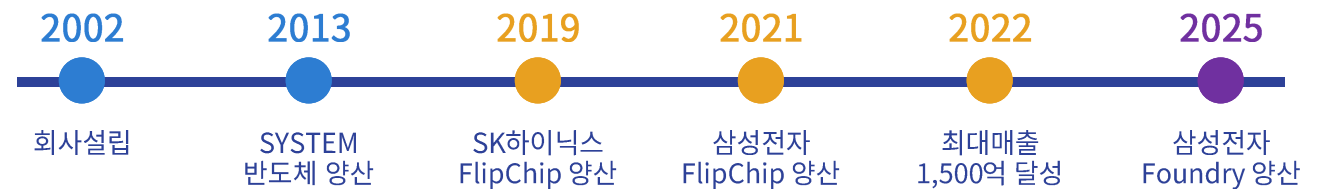
D 회사 개요

회사명	(주)윈팩
대표이사	신동호
설립일	2002년 4월 3일
본사	경기도 용인시 백암면
주요사업	반도체 Package 조립, Test
임직원 수	380명
자본금	690억원
KOSDAQ	2013년 3월 7일

D 주주현황

주주명	관계	주식 수	지분율
어보브반도체(주)	최대주주	12,770,503 주	46.80%
최 원	어보브반도체의 최대주주	70,883 주	0.26%
신동호	대표이사	46,302 주	0.17%
기타소액주주	기타	14,402,357 주	52.77%
발행주식총수		27,290,045 주	100.00%

D 연혁



D 시설 현황



▶ Total Space

AREA	SPACE (m ²)			
	Total	USE	FREE	UTZ
내부	29,639	21,498	8,141	73%
외부	29,752	12,413	17,339	42%
Total	59,391	33,911	25,480	57%

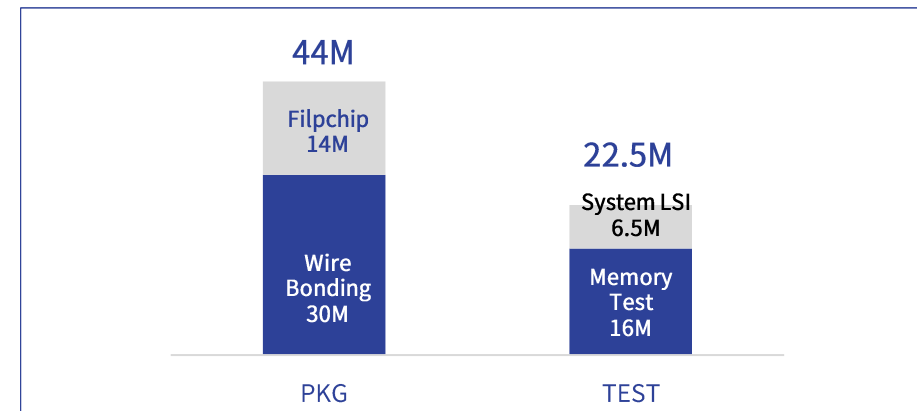
▶ Clean room space

Clean Room	SPACE (m ²)			
	Total	USE	FREE	UTZ
PKG	5,940	5,115	825	86%
TEST	4,950	3,960	990	80%
Total	10,890	9,075	1,815	83%

D 주요 장비

영역	공정	장비 수 (대)
PKG	Back grind	7
	Stealth dicing	3
	Die attach	38
	Wire bond	144
	Mold	10
	Solder mount	3
	Singulation	7
	DC Test	4
Test	Memory	62
	SOC	25
	EOL	13
Total		316대

D 월별 Capacity



Advanced Package 기술 기반 고객 맞춤형 Total Solution 제공

Memory부터 고성능 반도체까지 폭넓은 제품 포트폴리오 확보



메모리통합

eMCP uMCP

- 모바일 · 스마트폰
- IoT · 웨어러블 · 게이밍
- AI서버 · 자율주행 · ADAS



고성능 / 스토리지

FC-BGA eUFS4.0 BGA SSD

- AI서버 · 산업용 · 자동차
- 항공우주 · 자율주행



고주파

FC-QFN

- RF 통합 · 5G 칩셋
- RF 모듈 · USB 컨트롤러
- 위성통신



POP 기술

ePoP I-PoP

- 프리미엄 스마트폰
- 스마트워치

PKG 핵심역량

모바일, PC, 데이터센터, 자동차 등 고사양 제품군의 최적화된 첨단 반도체 패키지 기술을 제공



초소형화·초박형

AI, 자율주행, 5G 확산으로
패키지 기술 요구 수준 지속 상승



고성능·高신뢰성

첨단 스택킹 기술로
공정 기술 및 소재 고도화 실현



다기능·高효율

Wire Bonding → Flip Chip → TSV
→ Hybrid Bonding으로 기술 진화



첨단 패키지 포트폴리오

eMCP, uMCP, FC-BGA,
eUFS 4.0, ePoP, I-PoP 등 지원



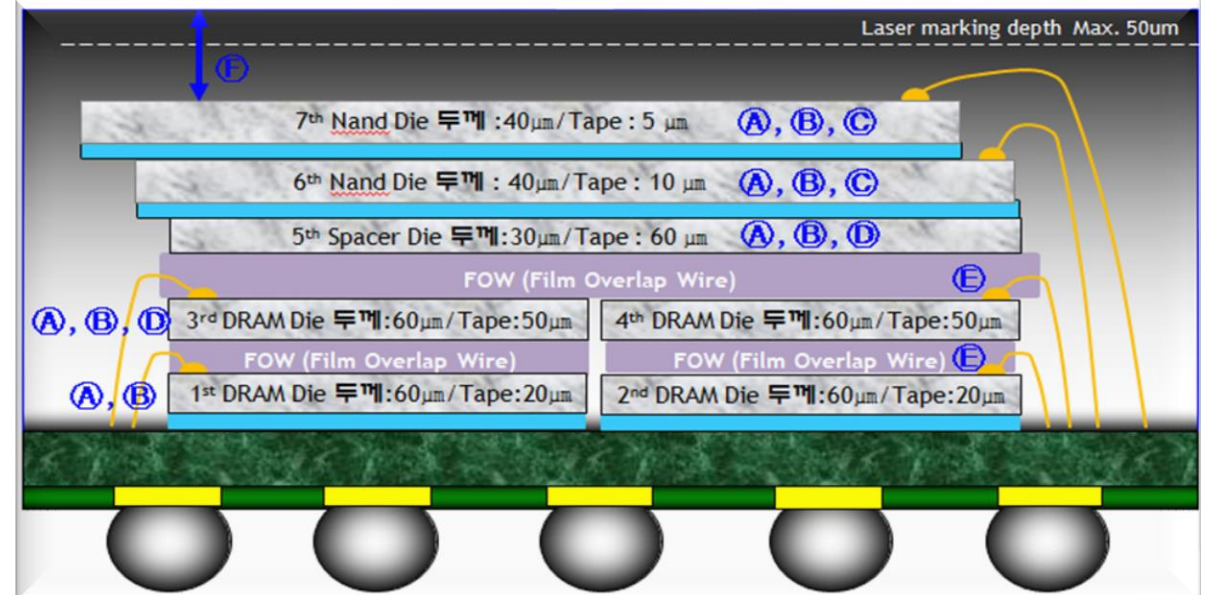
Total Solution 제공

소재·공정·설계·테스트 유
기적 통합으로
비로스 양산 역량 확보

핵심 기술 요약

A	Die Thickness	SDDG(Stealth Dicing Before Grind) 기술 적용 웨이퍼 박형화/박그라인딩 공정으로 다이 두께 60 μ m 이하 구현
B	Thin Die kit	Die Attach 공정에서 60 μ m 이하 초박형 다이를 파손 없이 픽업 Broken-Free 픽업 기술
C	Thin DAF	5 μ m / 10 μ m 두께의 초극박형 DAF (Die Attach Film) 적용 기술
D	FOW(Film Overlap Wire) tape	50 μ m / 60 μ m 와이어를 테이프로 덮어 감싸는 FOW 테이프 기술
E	Low Loop Height	상부 칩과의 간섭 방지를 위한 50~60 μ m 수준의 저루프 와이어 본딩 및 볼 넥(Ball Neck) 파단 방지 루핑 기술
F	Mold Narrow Top margin	C-MD(Compression Molding, 압축 몰딩) 공정으로 상부 마진(Top Margin) 약 110 μ m 구현 기술

첨단 패키지 구조 예시



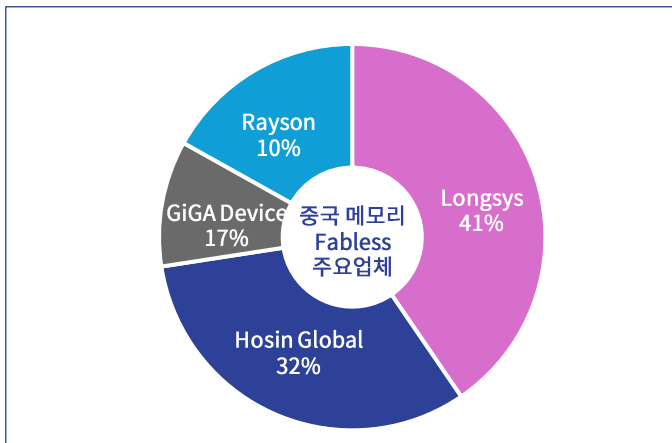
국내 시장의 한계를 넘어, 중국 메모리 Fabless 시장 공략

중국 메모리 Fabless 외주 시장은 국내 대비 약 6배 규모의 시장 기회

D 중국 메모리 Fabless 외주 시장 규모



D 중국 시장 규모 세부 Breakdown ('25년 추정)



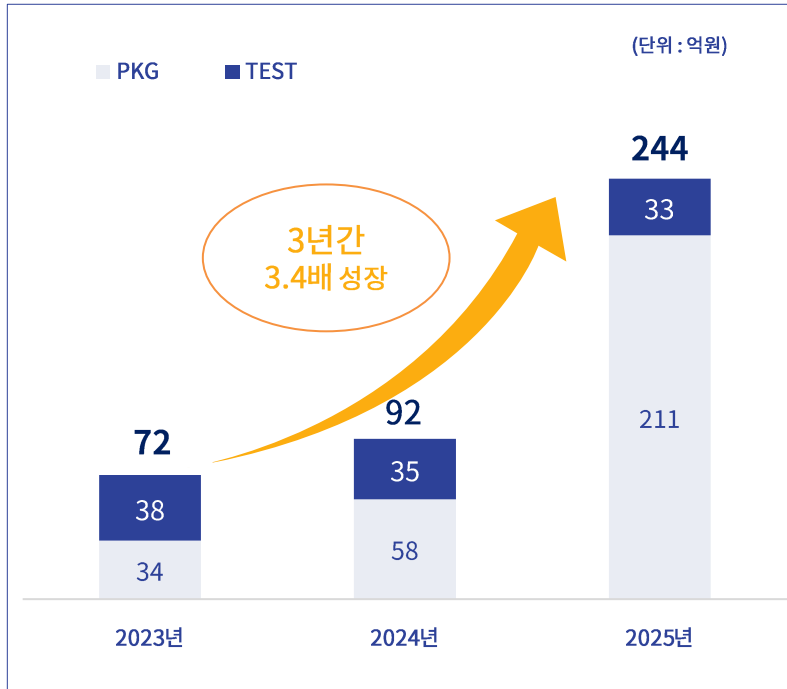
기업	연매출	우리나라 금액 환산	외주비용 (TAM)	주요제품
Longsys	227(억위안)	4조 7천억원	7,000 억원	SSD, eMMC, UFS, 메모리 모듈
Hosin Global	180(억위안)	3조 7천억원	5,600 억원	NAND FLASH, 등
Rayson	59(억위안)	1조 2천억원	1,800 억원	DDR3,4, LPDDR4/4X, LPDDR5, eMMC, eMCP
Giga Device	92(억위안)	1조 9천억원	2,800 억원	DDR, 플래시 메모리, 마이크로컨트롤러
Total	558(억위안)	11조 5,000억원	1조 7천억	

출처: 중국 공시시스템

중국 고객 확대와 기술 경쟁력 기반 성장 가속화

중국 Memory Fabless 시장 내 WINPAC의 입지 강화 및 차별화된 Advanced Package 경쟁력 확보

D 연도별 중국 매출액



D 기술 경쟁력 비교 (Leading Chinese OSAT 대비)

SAMSUNG	WINPAC Winner in Package & Test	비교항목	중국
22단	17단	Stacked Die	9단
HBM, Flipchip eMMC, uMCP	Flipchip, UFS4.0 eMMC, uMCP	Product	DDP, QDP, eMMC, eMCP,
30um	35um	BG Thickness	50um
30um 40um	35um 50um	Wire Bonding (Low Loop, Thin Fow)	50um 60um
99.7% 1,300PPM	99.6% 1,500PPM	수율 품질	99.2% 5,000PPM

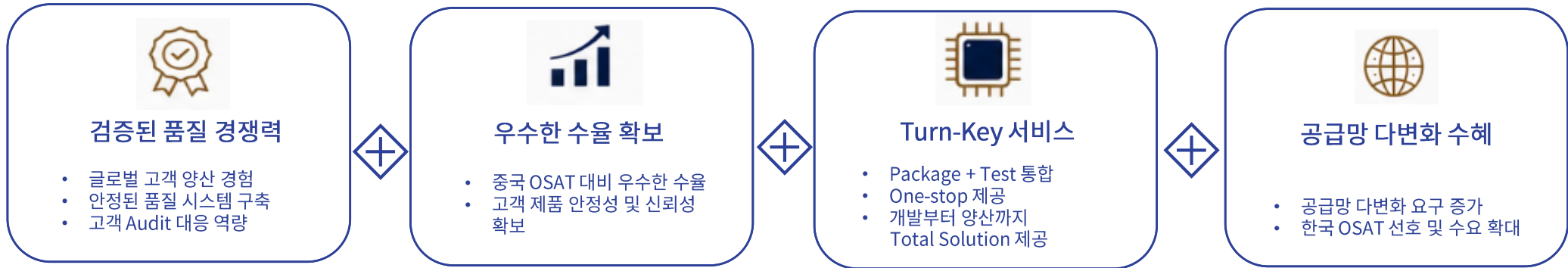
✓ 중국 고객 매출은 최근 3년간 지속적으로 증가하고 있으며, WINPAC의 고적층 Package 및 고품질 생산 역량을 기반으로 향후 중국 시장 확대를 지속 추진할 계획

시장다변화 - 중국 Fabless 시장 선점

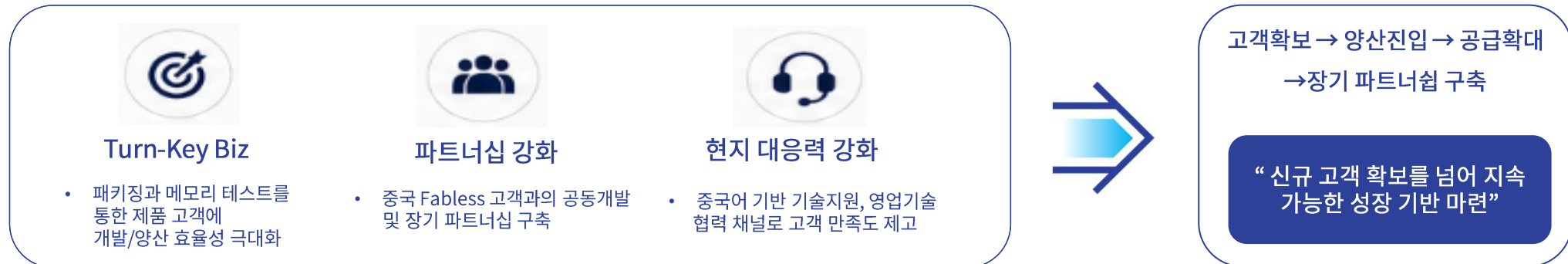
중국 업체 대비 차별화된 경쟁력을 기반으로 중국 고객 확대 추진

검증된 품질과 Turn-Key 역량을 기반으로 중국 Memory Fabless 고객 확대 추진

D 중국 시장 확대를 위한 WINPAC의 경쟁 우위



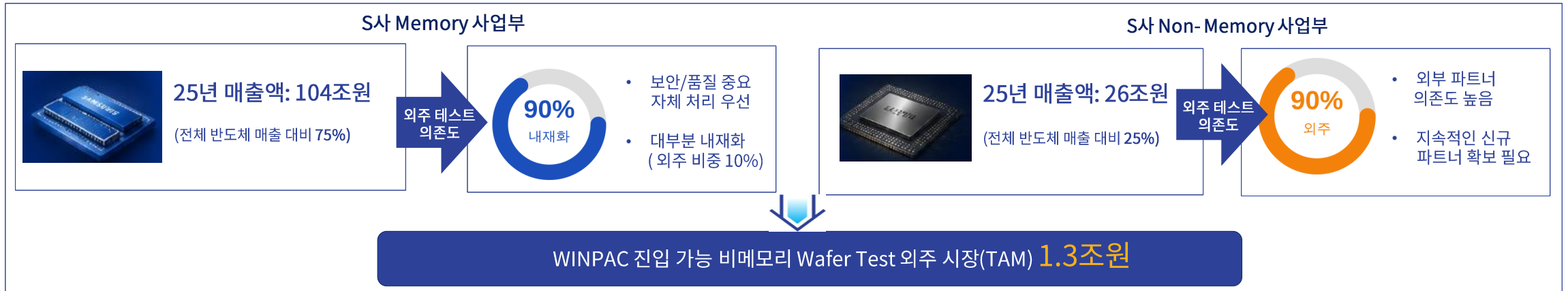
D 고객 확보 및 장기 파트너십 전략



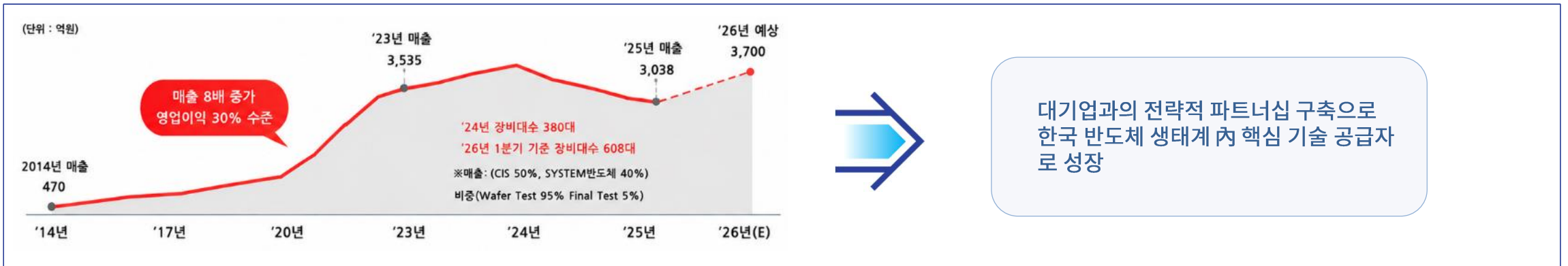
"S"사 비메모리 Wafer Test 시장 진입 기반 확보

대규모 외주 시장과 성공 사례가 입증하는 성장 잠재력

D S사 Wafer Test 시장 규모(`25년 S사 부문별 실적)



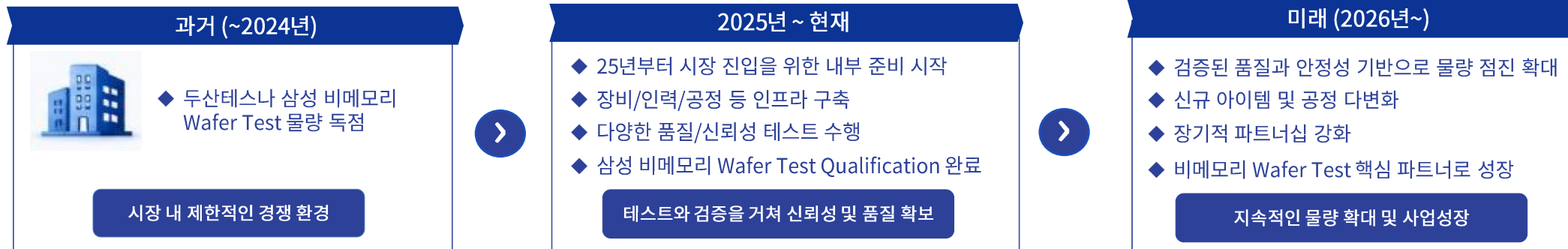
D 사업 다각화 성공사례- Wafer Test 전문기업(두산테스나)



차세대 성장동력, 비메모리 Wafer Test 사업 본격화

검증 완료를 기반으로 비메모리 Wafer Test 사업을 신규 성장축으로 육성

비메모리 Wafer Test 시장 진입



비메모리 Wafer Test 시장 진입



고부가가치 Wafer Test 진출로 성장 기반 구축

“S”사 Wafer Test 진입을 통해 매출 성장과 수익성 개선을 동시에 달성하고, 안정적 성장 기반을 구축

D Wafer Test 진출에 따른 기대효과

01 매출 성장

신규 Test 물량 확보로 매출 성장 견인

- ✓ S사 Wafer Test 물량 확보 및 단계적 확대
- ✓ Consign 장비 기반 CAPA 90대 확보
- ✓ 신규 아이템 및 고객 다변화로 매출 포트폴리오 강화

02 수익성 개선

고부가가치 Test 비중 확대를 통한 수익성 개선

- ✓ Wafer Test는 PKG 대비 높은 ASP 구조
- ✓ 초기 투자 부담이 적은 Consign 모델로 고정비 효율화
- ✓ 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과 극대화

03 사업 경쟁력 강화

기술·설비·고객 기반 종합 경쟁력 강화

- ✓ 선진 Wafer Test 기술 내재화
- ✓ Turn-key 서비스 제공으로 고객 Lock-in 강화
- ✓ 글로벌 OSAT Pool 진입 기반 마련

✓ Wafer Test 진출은 WINPAC의 수익 구조를 고도화하고, 지속 가능한 성장과 기업 가치 제고를 실현할 핵심 전략입니다.

Turn-Key 서비스 구축을 통한 수익구조 고도화

Turn-Key 서비스 고도화를 통해 고객, 사업, 수익구조가 선순환하는 지속가능한 성장 기반을 구축하겠습니다.



글로벌 선도 OSAT 기업

▶ Package & Test + 자체 Test PGM 역량을 기반으로 Full Turn-key Service 제공



AI·모바일 수요 확대에 따른 메모리 후공정 시장의 구조적 성장

▶ TEST 일원화 요구 확산 → One-Stop OSAT 경쟁력 부각 (관리 효율성 및 Total Cost 절감 효과)



Turn-key 구축을 위한 3단계 전략

내재 역량 강화
(기존 PKG & TEST)



MT PGM 개발 역량 확보
(Memory Final Test)



Lock-in 구조 구축
(고객 맞춤형 PGM)



고객 가치 제고

- 일관된 제품 특성 및 품질 안정화
- 리드타임 단축 (Time-to-Market)
- 비용 절감 및 책임소재 명확화



고객 Lock-in 강화

- 주요 고객사 Turn-key 수주 확보
- 고객 맞춤형 PGM 제공으로 고객 전환 비용 증가로 장기 거래 관계 구축



매출 성장 및 수익성 개선

- 통합 서비스로 연매출 성장 확대
- 중장기 글로벌 메모리 OSAT 기업 도약
- PGM 경쟁력 기반 고부가가치화

Memory PKG 중심 OSAT → Global Turn-Key OSAT

사업구조 개선 및 미래 성장동력을 통하여 실적 정상화 및 기업가치 재평가 구간 진입

1 수익구조 정상화

구조조정과 운영 효율화를 통한 수익성 개선 기반 확보



- ✓ 비용 효율화 작업 완료
- ✓ 메모리 업황 회복 수혜
- ✓ 비핵심 사업 축소 및 운영 효율화 작업 완료
- ✓ 안정적 재무구조 구축

2 중국 Fabless 시장 확대

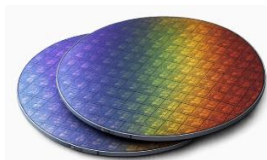
중국 메모리 Fabless 고객사 확대를 통한 매출 성장 가속화



- ✓ Longsys, Rayson, Xincenda 등 주요 고객사 확보
- ✓ 최근 3년간 중국 고객 매출 3.4배 성장 (72억원 → 244억원 (3.4X Growth))
- ✓ 중국 Fabless 시장 선점을 통한 자족적인 성장 기반 확보

3 “S”사 Wafer Test 성장축 확보

Qualification 완료 기반 사업 확대



- ✓ 2025년 Qual 완료 및 Consign 장비 2대 운영 중
- ✓ 2026년 15대 → 2028년 90대 확대 계획
- ✓ 기존 저마진 PKG 위주 → 고마진 Test 사업으로 확장

4 Turn-Key OSAT 구축

One-Stop 서비스 제공으로 고객 가치 극대화



- ✓ 설계 → Wafer Test → PKG → Final Test 통합 서비스
- ✓ 고객 개발 기간 단축 및 비용 절감
- ✓ 고객 Lock-in 효과로 고객당 매출 확대



주식회사 윈팩 | WINPAC, Inc.

For more information,
<http://www.winpac.co.kr>